



慕尼黑上海电子展

electronica & Productronica China 2010

第九届中国国际电子元器件、组件、生产设备博览会



2010年3月16-18日

上海新国际博览中心

Shanghai New International Expo Centre

www.e-p-china.com.cn

中国电子制造年会 IPC CEMAC 2010

时间 : 2010年3月16-18日

Date : March 16-18, 2010

地点 : 上海新国际博览中心, E1馆 M15, M16 会议室

Venue: Shanghai New International Expo Center, Conference Room E1-M15, M16

主办单位 : IPC-国际电子工业联接协会

中国印刷电路行业协会(CPCA)

Organizers: IPC

China Printed Circuit Association

战略支持 : 德国慕尼黑国际博览集团

Strategic Support: Messe München International

3月16日 (周二) March 16 (Tuesday)

时间 Time	演讲题目 Topic	演讲人 Speaker
13:15-13:30	开幕讲话 Opening Speech	
13:30-14:10	电信行业2010年面临的全球性挑战 The Global Challenges of IT industry in 2010	陈锦标, 香港采购供应专业协会主席
14:10-14:50	PCB在服务器的发展趋势和机会 The Trend and Opportunity of Computer Server PCB	梁健斌, IBM采购(中国)有限公司资深全球采购经理
14:50-15:00	休息 Break	
15:00-15:40	气候变化意味着什么? A Change in Climate?	Christopher Hazen, WSP Environment & Energy
15:40-16:20	欧洲PCB市场分析 Europe PCB Markets Analysis	Michael Weinhold, EIPC (欧洲印制电路板协会)
16:20-17:00	印制电子应用路线图 Printed Electronics Application Roadmap	沃富冈·克莱蒙斯博士 (Dr. Wolfgang Clemens) PolyIC公司

3月17日 (周三) March 17 (Wednesday)

时间 Time	演讲题目 Topic	演讲人 Speaker
组装分会场 EMS Session		
9:20-9:30	欢迎词 Welcome Message	
9:30-10:10	透过现象看本质——从无卤无铅、RoHS、REACH, 到节能减排, 再到可持续发展面面观 Sustainable development concept on Lead free/halogen free, RoHS, REACH and energy-saving	李信柱, 通标公司 Sean Li, SGS

MMI (Shanghai) Co., Ltd.

11th floor, GC Tower, 1088 Yuanshen Road, Pudong New Area, Shanghai 200122
Tel: (86 21) 20205500 Fax: (86 21) 20205688 E-mail: epc@mmi-shanghai.com



慕尼黑上海电子展

electronica & Productronica China 2010

第九届中国国际电子元器件、组件、生产设备博览会



2010年3月16-18日

上海新国际博览中心

Shanghai New International Expo Centre

www.e-p-china.com.cn

10:10-10:50	底部填充工艺的持续优化 Increasing Value of Under fill process	Dan Ashley Asymtek 中国
10:50-11:30	抗BGA枕头缺陷免洗无铅无卤焊膏评估 Anti BGA Head-in-Pillow Defect No-Clean Pb-free Halogen-free Solder Paste Evaluation	夏川, 思科系统 Xia Chuan, Cisco
11:30-12:10	PCB和PCBA短路不良巡航扫雷法解决方案 Navigational Mine-Sweeping Solution for PCB/PCBA Short Defect	孙鹏, Esamber Spark Sun, Esamber
12:10-13:30	午餐	
13:30-14:20	优化混合装配技术中的印刷工艺 Optimising the print process for Mixed Technology	李亿, DEK中国 Li Yi, DEK China
14:20-15:00	底部填充材料对薄型球形栅格阵列封装组件机械弯曲可靠性的影响 Effects of Underfill Materials on Mechanical Bend Reliability of Thin Ball Grid Array Assembly	史洪宾, 广达电脑 Kevin Shi, Quanta
15:00-15:40	EMS工厂的工艺生产及技术开发管理模式 EMS model shop flow & process control	颜梅, 伟创力苏州 May Yan, Flextronics
15:40-16:20	应对电子装配中枕头效应缺陷的挑战 Addressing the Challenge of Head-in-Pillow Defects in Electronics Assembly	严俊杰 Aaron Yan 美国镭公司 (Indium)
16:20-17:00	待定(TBA)	

3月18日 (周四) March 18 (Thursday)

时间 Time	演讲题目 Topic	演讲人 Speaker
组装分会场 EMS Session		
9:30-10:10	夹具波峰焊过孔连锡问题研究 Solder Bridging Between Vias during Fixture-Wave Soldering	孙正宝 华为技术
10:10-10:50	可靠性相关标准介绍 Introduction of IPC standards on Reliability	David Bergman IPC
10:50-11:30	减缓高污染环境下的印制电路板的腐蚀 Slowing Corrosion on PCB's in Highly Polluted Environments	Jim Kenny 确信电子-乐思化学
11:30-12:10	PCB喷淋系统应用浅谈 Application of PCB Spray System	何平等 东莞生益电子有限公司